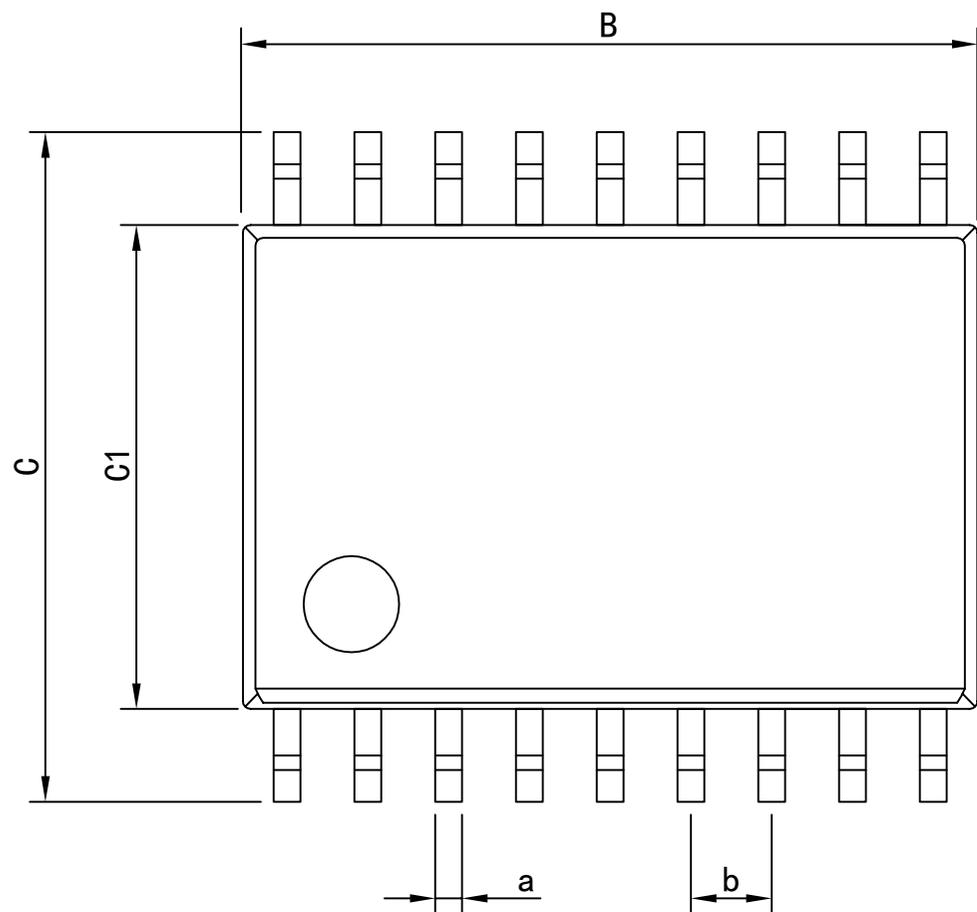
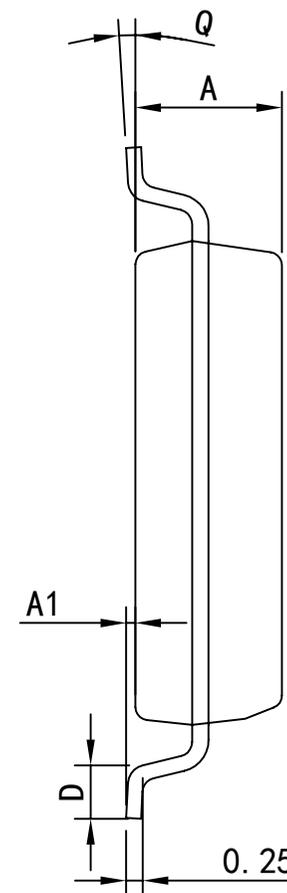




华冠半导体

广东华冠半导体有限公司
Guangdong Huaguan Semiconductor Co., Ltd.



制图	赖谊成
审阅	罗云龙
核准	林钟涛

SOP-18

文件名称:
HG-SOP18

文件编号:
HGWXT-230018

版本 VI.0

比例 1:1

单位 mm

日期 2023-6-28

图纸幅面 A4



第一角法

UNITT: mm

DIM.	A	A1	B	C	C1	D	Q	a	b			
MIN	2.10	0.08	11.25	10.10	7.30	0.70	0°	0.35	1.27			
MAX	2.50	0.28	11.65	10.50	7.70	1.00	8°	0.44	BSC			